

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

广东嘉元科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他 ☐ 分析师会议 ☒ 业绩说明会 ☐ 路演活动
参与活动单位名称	通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）参与网络文字互动方式参与 2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的投资者
时间	2025 年 9 月 19 日（周五）下午 15:30~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长：廖平元先生； 董事、总裁（总经理）：杨剑文先生； 董事会秘书、副总裁：李恒宏先生； 财务负责人：廖国颂先生； 总工程师：王俊锋先生； 独立董事兼审计委员会主任委员：夏芸女士。
投资者关系活动主要内容介绍	投资者关系活动的主要内容如下： 为进一步加强与投资者的互动交流，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“向新提质价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交流。 投资者提出的问题及公司回复情况： 一、请问核心的 PCB 业务和 CPO 未来半年的预期业绩和创新特点是什么？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司持续深化“生产一代，储备一代，预研一代”技术战略，在高端电子电路铜箔领域实现多项突破，公司将持续开发契合市场趋势的新产品，不断丰富和优化产品结构，逐步提升高端电子电路铜箔等高附加值产品的占比，有效提升产品品质，以技术创新提升产品竞争力与

市场份额。基于公司发展战略及经营规划，推动公司立足现有新能源业务寻求外延式发展，进一步扩大业务及收入规模，发展新的利润增长点，本次公司对外投资的目标公司所处行业为光模块行业，属于公司拓展的新业务，公司本次对外投资可能存在市场风险、财务风险、管理风险以及相关股份的交割、过户、工商变更等事项能否最终顺利完成等不确定因素，敬请广大投资者注意风险。感谢您的关注！

二、请分别介绍一下公司六个基地的在产产能在建产能和规划产能情况。谢谢。

回复：尊敬的投资者，您好！公司六个基地年产能规划合计达 25 万吨以上。目前雁洋基地、白渡基地、山东基地、宁德基地均已全面投产，江西基地、嘉元时代均仍在产能爬坡中，目前公司铜箔年产能达 13 万吨以上，公司将把握市场机遇，加快产能释放。感谢您的关注！

三、请问廖董事长，贵公司 HVLP-1、2、3 铜箔有无定点客户，能否切入头部大客户？

回复：尊敬的投资者，您好！公司在江西赣州龙南布局的电解铜箔生产线规划总产能为 3.5 万吨，现已投产产能达 1 万吨以上，该产线主要生产电子电路铜箔产品，其中高端产品可应用于 AI 服务器的 PCB，目前高端电子电路铜箔中的 HVLP 铜箔产品正在客户验证阶段中。此外，公司还布局了用于芯片封装可剥离超薄铜箔相关项目，预计首条生产线将于 2025 年第四季度开始试产，2026 年底可实现 70 万平方米/年。未来，公司将持续开发契合市场趋势的新产品，不断丰富和优化产品结构，逐步提升高端电子电路铜箔等高附加值产品的占比，有效提升产品品质，以技术创新提升产品竞争力与市场份额。感谢您的关注！

四、请问廖董事长，后续有继续收购、控股恩达通的计划吗？

回复：尊敬的投资者，您好！如有相关计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

五、请问公司在 pcb 业务的占比，以及公司在高端铜箔的发展情况？

回复：尊敬的投资者，您好！为实现高端电子电路铜箔的国产替代，公司持续增加研发投入，在 PCB 铜箔领域的发展战略主要围绕高端化、差异化展开，重点布局高频高速电路用铜箔、高密度互连（HDI）铜箔、甚低轮廓（HVLP）、载体铜箔（DTH）及特种功能铜箔等高端应用产品，以满足 AI、算力、5G 等新兴领域对高性能 PCB 的需求。公司持续深化“生产一代、储备一代、研发一代”战略，进一步加快各类高性能电解铜箔产品的研发和制造，强化与下游客户合作，推动高端电子电路铜箔的国产替代进程，取得了高阶 RTF（反转铜箔）、HTE（高温高延伸铜箔）、HVLP（极低轮廓铜箔）、载体铜箔（DTH）和高密度互连电路（HDI）铜箔等高性能电子电路铜箔的技术突破，PCB 用超薄铜箔（UTF）已批量生产，高频高速电路和 IC 封装应用的 RTF/HVLP 等电子电路铜箔产品的开发方面取得了积极进展，其中 RTF 已通过头部企业认证测试并具备量产能力，其他产品也已通过实验室验证阶段并与下游客户进行测试。

公司在江西赣州龙南布局的电解铜箔生产线规划总产能为 3.5 万吨，现已投产产能达 1 万吨以上，该产线主要生产电子电路铜箔产品，其中高端产品可应用于 AI 服务器的 PCB，目前高端电子电路铜箔中的 HVLP 铜箔产品正在客户验证阶段中。此外，公司还布局了用于芯片封装可剥离超薄铜箔相关项目，预

	计首条生产线将于 2025 年第四季度开始试产， 2026 年底可实现 70 万平方米/年。未来，公司将持续开发契合市场趋势的新产品，不断丰富和优化产品结构，逐步提升高端电子电路铜箔等高附加值产品的占比，有效提升产品品质，以技术创新提升产品竞争力与市场份额。 公司在高端锂电铜箔产品市场竞争力强劲，市占率达 50%，稳居行业前列。锂电铜箔产品矩阵丰富，覆盖极薄、中高强、超高强、特高强等全系列产品。在极薄铜箔领域，4.5 微米、4 微米产品已实现大批量稳定供货，3.5 微米产品进入小批量供应阶段，3 微米产品更率先具备量产实力。中高强铜箔出货量占比超 50%，已成为主力产品；超高强铜箔已实现规模化供应，特高强铜箔也通过了客户的测试，已开始批量供应。 同时，公司时刻关注全固态电池发展动向，联动下游企业同步进行全固态电池不同技术路线所需新型负极集流体产品的相关研究及送样工作。2024 年公司推出高比表面拓界铜箔，针对性解决了固态电池负极集流体固固界面接触面积不足与界面阻抗难题；同年推出采用多元金属复合技术的特种合金铜箔，攻克固态电池集流体高能量密度下在高温、高电压下的结构失稳与界面失效难题；2025 年公司推出双面镀镍铜箔，针对性解决固态电池中负极集流体不耐高温、不耐腐蚀的难题，已适配半固态/固态电池技术。 目前，公司是少数在固态电池领域取得商业化进展的公司，公司的铜箔产品已覆盖半固态电池和全固态电池不同技术路线所需铜箔，已向多家企业批量供货，预计未来供货量将不断提升。公司的固态电池铜箔产品，除了用于新能源车，还用于低空经济。其中，耐高温铜箔在固态电池中运用并搭载于头部厂商发布的 eVTOL（电动垂直起降飞行器）。2025 年公司固态电池铜箔出货量预计为 100 吨左右，约占公司整体出货量的 1%。除批量供货与测试送样客户外，公司还与多家客户达成战
--	---

	略协议，按客户要求开发定制化铜箔产品。 此外，公司自 2017 研发出多孔铜箔，从第一代的机械冲孔、第二代的激光打孔、目前已进入到第三代。通过三维多孔骨架结构，解决固态电池负极锂金属沉积不均匀与枝晶穿透风险。2023 年推出的复合铜箔，采用高分子基膜-金属镀层复合结构，可解决固态电池轻量化与本质安全的协同难题，为高安全、长寿命固态电池金属负极体系产业化提供核心材料支撑。感谢您的关注！ 六、请问贵司在 MLCP 技术方面有什么布局？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司主要从事各类电解铜箔的研发、制造和销售。感谢您的关注！ 七、请问贵司在铜缆高速链接方面有什么布局？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司控股孙公司湖南嘉元隆源科技有限公司从事精密铜线加工业务，未来将加速扩大嘉元隆源高端精密铜线产能规模，加快推进裸铜线、裸铜绞线及在铜缆高速链接方面的布局。感谢您的关注！ 八、廖总您好，今年铜箔加工费是否有所提升？ 回复：尊敬的投资者，您好！去年铜箔加工费已经进入底部，目前部分产品加工费已有所回升，在需求增长的驱动下，锂电池行业复苏迹象明显，处于逐步向好的态势。公司预计今年部分高端定制化产品的加工费仍有上涨空间，涨幅情况需结合下半年市场供需情况、客户订单情况等因素综合判断。公司将持续加强与客户的沟通合作，提升公司的竞争力和盈利能力。同时，公司也将不断优化产品结构，提高产品质量和服务水平。今年下半年，随着高附加值产品占比的提升、海外客户的导入及销售的放量，将为公司带来更多的盈利增长点，不断
--	---

提升公司盈利能力和市场竞争力。感谢您的关注！

九、请问，恩达通公司是否为美国甲骨文（Oracle）供应商？400G 和 800G 的份额如何？

回复：尊敬的投资者，您好！公司近期对外投资的武汉恩达通科技有限公司是美国甲骨文（Oracle）的主要供应商之一，光模块产品 400G 和 800G 根据客户的需求动态变化。感谢您的关注！

十、请问廖董事长，能否介绍下恩达通对外销售的光模块的产品型号有哪些？

回复：尊敬的投资者，您好！公司近期对外投资的武汉恩达通科技有限公司对外销售的光模块产品主要为 100G、400G、800G 及 1.6T 等光模块产品。感谢您的关注！

十一、请问公司对武汉恩达通科技有限公司后续还会追加投资吗？武汉恩达通科技有限公司的主要客户有哪些？

回复：尊敬的投资者，您好！公司近期对外投资的武汉恩达通科技有限公司的主要客户为云计算数据中心、无线接入以及传输等领域海外知名客户。如后续有相关计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

十二、请问公司在机器人方面的布局？

回复：尊敬的投资者，您好！公司主要从事各类电解铜箔的研发、制造和销售，目前公司暂无机器人方面相关布局，公司铜箔产品和高性能精密铜线产品可应用于机器人领域。感谢您的关注！

十三、请问公司在 pcb 生产情况，以及高端铜箔发展情况？

回复：尊敬的投资者，您好！为实现高端电子电路铜箔的

	国产替代，公司持续增加研发投入，在 PCB 铜箔领域的发展战略主要围绕高端化、差异化展开，重点布局高频高速电路用铜箔、高密度互连（HDI）铜箔、甚低轮廓（HVLP）、载体铜箔（DTH）及特种功能铜箔等高端应用产品，以满足 AI、算力、5G 等新兴领域对高性能 PCB 的需求。公司持续深化“生产一代、储备一代、研发一代”战略，进一步加快各类高性能电解铜箔产品的研发和制造，强化与下游客户合作，推动高端电子电路铜箔的国产替代进程，取得了高阶 RTF（反转铜箔）、HTE（高温高延伸铜箔）、HVLP（极低轮廓铜箔）、载体铜箔（DTH）和高密度互连电路（HDI）铜箔等高性能电子电路铜箔的技术突破，PCB 用超薄铜箔（UTF）已批量生产，高频高速电路和 IC 封装应用的 RTF/HVLP 等电子电路铜箔产品的开发方面取得了积极进展，其中 RTF 已通过头部企业认证测试并具备量产能力，其他产品也已通过实验室验证阶段并与下游客户进行测试。 公司在江西赣州龙南布局的电解铜箔生产线规划总产能为 3.5 万吨，现已投产产能达 1 万吨以上，该产线主要生产电子电路铜箔产品，其中高端产品可应用于 AI 服务器的 PCB，目前高端电子电路铜箔中的 HVLP 铜箔产品正在客户验证阶段中。此外，公司还布局了用于芯片封装可剥离超薄铜箔相关项目，预计首条生产线将于 2025 年第四季度开始试产，2026 年底可实现 70 万平方米/年。未来，公司将持续开发契合市场趋势的新产品，不断丰富和优化产品结构，逐步提升高端电子电路铜箔等高附加值产品的占比，有效提升产品品质，以技术创新提升产品竞争力与市场份额。 公司在高端锂电铜箔产品市场竞争力强劲，市占率达 50%，稳居行业前列。锂电铜箔产品矩阵丰富，覆盖极薄、中高强、超高强、特高强等全系列产品。在极薄铜箔领域，4.5 微米、4 微米产品已实现大批量稳定供货，3.5 微米产品进入小批
--	---

	量供应阶段，3 微米产品更率先具备量产实力。中高强铜箔出货量占比超 50%，已成为主力产品；超高强铜箔已实现规模化供应，特高强铜箔也通过了客户的测试，已开始批量供应。 同时，公司时刻关注全固态电池发展动向，联动下游企业同步进行全固态电池不同技术路线所需新型负极集流体产品的相关研究及送样工作。2024 年公司推出高比表面拓界铜箔，针对性解决了固态电池负极集流体固固界面接触面积不足与界面阻抗难题；同年推出采用多元金属复合技术的特种合金铜箔，攻克固态电池集流体高能量密度下在高温、高电压下的结构失稳与界面失效难题；2025 年公司推出双面镀镍铜箔，针对性解决固态电池中负极集流体不耐高温、不耐腐蚀的难题，已适配半固态/固态电池技术。 目前，公司是少数在固态电池领域取得商业化进展的公司，公司的铜箔产品已覆盖半固态电池和全固态电池不同技术路线所需铜箔，已向多家企业批量供货，预计未来供货量将不断提升。公司的固态电池铜箔产品，除了用于新能源车，还用于低空经济。其中，耐高温铜箔在固态电池中运用并搭载于头部厂商发布的 eVTOL（电动垂直起降飞行器）。2025 年公司固态电池铜箔出货量预计为 100 吨左右，约占公司整体出货量的 1%。除批量供货与测试送样客户外，公司还与多家客户达成战略合作协议，按客户要求开发定制化铜箔产品。 此外，公司自 2017 研发出多孔铜箔，从第一代的机械冲孔、第二代的激光打孔、目前已进入到第三代。通过三维多孔骨架结构，解决固态电池负极锂金属沉积不均匀与枝晶穿透风险。2023 年推出的复合铜箔，采用高分子基膜-金属镀层复合结构，可解决固态电池轻量化与本质安全的协同难题，为高安全、长寿命固态电池金属负极体系产业化提供核心材料支撑。 感谢您的关注！
--	---

十四、嘉元科技的PCB铜箔占比多少啊？

回复：尊敬的投资者，您好！公司2025年上半年电子电路铜箔销售收入占比约5%。感谢您的关注！

十五、贵公司生产的极薄铜箔市占率全球第一吗？？

回复：尊敬的投资者，您好！公司锂电铜箔产线高效运转，稼动率达到95%，充分释放产能优势。高端锂电铜箔产品市场竞争力强劲，市占率达50%，稳居行业前列。公司锂电铜箔产品矩阵丰富，覆盖极薄、中高强、超高强、特高强等全系列产品。在极薄铜箔领域，4.5微米、4微米产品已实现大批量稳定供货，3.5微米产品进入小批量供应阶段，3微米产品更率先具备量产实力。中高强铜箔出货量占比超50%，已成为主力产品；超高强铜箔已实现规模化供应，特高强铜箔也通过客户的测试通过，已开始批量供应。感谢您的关注！

十六、在PCB铜箔领域，请介绍一下HVLP 1-4代全系列产品量产情况？

回复：尊敬的投资者，您好！公司在江西赣州龙南布局的电解铜箔生产线规划总产能为3.5万吨，现已投产产能达1万吨以上，该产线主要生产电子电路铜箔产品，其中高端产品可应用于AI服务器的PCB，目前高端电子电路铜箔中的HVLP铜箔产品正在客户验证阶段中。此外，公司还布局了用于芯片封装可剥离超薄铜箔相关项目，预计首条生产线将于2025年第四季度开始试产，2026年底可实现70万平方米/年。未来，公司将持续开发契合市场趋势的新产品，不断丰富和优化产品结构，逐步提升高端电子电路铜箔等高附加值产品的占比，有效提升产品品质，以技术创新提升产品竞争力与市场份额。感谢您的关注！

附件清单（如有）	
日期	2025 年 9 月 19 日